

洁盟 JM-ZK-20D 真空等离子清洗机技术规格

产品图（暂无）

一、产品功能及特点

- 1、可采用不同的气体介质进行处理（氧气、氮气、氩气、氢气或混合气体等气体），对材料最终的表面化学结构和性质有较好的可控性
- 2、不分处理对象的基材类型,只要在此容量下的物件,均可进行处理,如金属、半导体、氧化物和大多数高分子材料等
- 3、配置灵活,可配置不同频率及功率,同时控制系统选择了 PLC 微电脑控制,操作方便快捷
- 4、卓越的密封性,高真空度真空腔体设计及制造工艺
- 5、真空室等离子体分布均匀,较低的处理温度,不存在热损伤和热氧化的问题
- 6、高度自动化作业,减少人员干预,降低二次污染风险

二、产品技术参数

| | |
|--------|------------------------------|
| 腔体容量 | 约 20L; W260mm*H260mm*D300mm |
| 射频电源 | 1000W, 40kHz; 300W, 13.56MHz |
| 电极层数 | 1-4 层可选 |
| 真空计 | $1*10^{-2} \sim 1*10^5$ |
| 流量计 | 2-4 通道 MFC |
| 极限真空度 | 20Pa 或更低 |
| 控制系统 | 10 寸 PLC 触摸屏（手动/自动） |
| 工艺气体 | 氧气、氮气、氩气、氢气或混合气体 |
| 工艺气体接口 | I.D 4mm, O.D 6mm |
| 主机尺寸 | W800mm; H800mm; D1800mm |
| 配套附件 | 真空泵 1 台（可选干泵或者油泵），波纹管 1 条； |
| 安装电源 | 380V/16A |



三、应用场景

汽车制造零部件、牙科、生物医疗清洗处理、晶圆表面处理、聚合物表面处理。

电子元件、小型 PCB 清洗、IC 芯片、半导体硅片等表面清洁、活化增强绑定性等。

精密元件清洗处理、晶圆表面处理、聚合物表面处理。

触摸屏：LCD/OLED/TP 贴合前，表面清洁活化

手机摄像头模组清洁，LENS/微马达（VCM）组装前清洗

玻璃盖板：提高盖板表面活性、去静电、增加镀膜附着力

PVC\PET\ABS 智能卡片喷码前预处理

印字前处理，可使印字更牢固，不脱落

涂层前处理，使涂层更牢固